Searching PAJ

10/7/9,382 1/1 ページ

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-175855

(43)Date of publication of application: 21.06.2002

(51)Int_CI.

HO1R 13/631 HO1R 13/639 HO1R 13/64 H01R 12/22 H01R 12/16 // H01R107:00

(21)Application number: 2000-374845

(71)Applicant:

JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY LTD

(22)Date of filing:

08.12.2000

(72)Inventor:

YAHIRO YASUFUMI

NATORI AKIRA

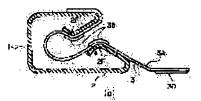
SUZUKI KEIICHIRO

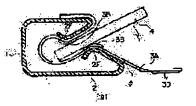
(54) CONNECTOR

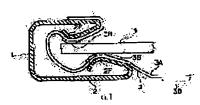
(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To remove a press fit structure to the housing of a contact, secure a holding force of the contact in the housing, improve the structural strength of the contact, and provide a connector having a superior electrical characteristics.

SOLUTION: At both sides of top and bottom in inside of the housing 2 of the connector 1, an elastic part 2F for pressing force generation is installed. At two places of upper face of a thin plate state cable 3, joint parts 3B are installed, and at a lower face, a soft soldering pad 3D for substrate connection is installed. A small-sized substrate 4 is slantingly inserted into the housing, and next, is rotated into an arrow head direction, and made to reach the horizontal state. Then, respective contact point parts (not illustrated), installed at both front and rear faces of a small-sized substrate, are press-contacted with respective joint parts 3B of the thin plate cable by the resiliency of elastic part for generation of respective pressing force.







LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

08.12.2000

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

17.11.2004

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出顧公園番号 特開2002-175855 (P2002-175855A)

(43)公開日 平成14年6月21日(2002.6.21)

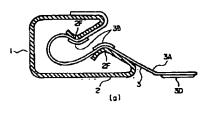
(51) Int.Cl."	識別記号			F I					テ ーマコート*(参考)				
H01R	24/00			H0	1 R	13/631					5 E 0 2	3 1	
	13/631					13/639				Z	5 E O 2	3	
	13/639	· 答弦			1	107: 00							
	13/64				23/02 13/64					D			
	12/22									Z			
_			蘇查請求	有	新求	項の数5	OL	全	8	頁)	最終頁	に続く	
(21)出願番号		特爾2000-374845(P2000-374	1845)	(71) 出顧		000231	1073						
			-			日本航	空電子	工業物	弑	会社			
(22)出顧日		平成12年12月8日(2000.12.8)				東京都	渋谷区	道玄	反1	丁目	21番2号		
				(72)発明者 八			康文						
						東京都	被谷区	道玄	反1	丁目	21番2号	日本	
						航空電	子工業	株式会	社	内			
				(72)	発明者	る 名取	掌						
						東京都	被谷区	道玄技	反1	丁目	21番2号	日本	
			}	航空電子工業株式				株式会	社	内			
			1	(74)	代理人	10007	1272						
						弁理士	後藤	群力	1	(4	1名)		
										最終頁に続く			

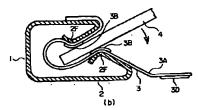
(54) 【発明の名称】 コネクタ

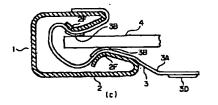
(57)【要約】

【課題】 コンタクトのハウジングへの圧入構造を除去し、ハウジングにおけるコンタクトの保持力を確保し、コンタクトの構造的強度を向上し、しかも、電気的特性が良好なコネクタを提供する。

【解決手段】 コネクタ1のハウジング2の内部における上下両側に押圧力発生用弾性部2Fを設ける。薄板状ケーブル3の上面の2箇所に接点部3Bを設け、下面に基板接続用半田付パッド3Dを設ける。小型基板4をハウジングに対して傾斜して挿入し、次に、矢印方向に回転させ、水平状態まで至らせる。すると、小型基板の表裏両面に設けられた各接点部(図示せず)は、薄板状ケーブルの各接点部3Bに各押圧力発生用弾性部の弾力性により押圧接触する。







(2)

特開2002-175855

【特許請求の範囲】

【請求項1】 接続対象物が傾斜して挿入された後に回 転されて接続するコネクタにおいて、

1

前記コネクタは、金属製のハウジングとコンタクトとか ら構成され、

前記ハウジングには、前記接続対象物を保持するための ラッチが一体に形成され、

前記コンタクトは、絶縁フィルムと、前記絶縁フィルム 上に設けられ、かつ、前記接続対象物と接続する接点部 と、前記絶縁フイルム上に設けられ、かつ、基板に接続 10 する端子部と、前記接点部と前記端子部との間を接続す る接続部とから構成され、

前記ハウジングは、前記コンタクトの接点部を前記接続 対象物に対して押圧する弾性部を有し、少なくとも前記 コンタクトの接点部が前記弾性部に固着されていること を特徴とするコネクタ。

【請求項2】 前記弾性部と前記ハウジングとが一体に 形成されていることを特徴とする請求項1記載のコネク タ。

【請求項3】 前記コネクタを前記基板に保持するため 20 のホールドダウンと前記ハウジングとが一体に形成され ていることを特徴とする請求項1記載のコネクタ。

【請求項4】 前記接続対象物が前記コネクタに挿入さ れる際、前記接続対象物の両側を挟持する一対のばね片 と前記ハウジングとが一体に形成されていることを特徴 とする請求項1記載のコネクタ。

【請求項5】 前記接続対象物が前記コネクタに挿入さ れる際、前記接続対象物の表裏逆の挿入の防止及び挿入 の位置決めを行う極性キーと前記ハウジングとが一体に 形成されていることを特徴とする請求項1記載のコネク 30 ことは困難である。 タ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、小型基板等の接続 対象物が傾斜して挿入された後に回転されて接続するコ ネクタに関する。

[0002]

【従来の技術】特許第3069947号公報に記載され た平行基板接続用コネクタの要点について図14を参照 して説明する。

【0003】図14(a)に示されるような回路基板2 1を2枚相互に接続するコネクタとして、図14(b) に示されるようなコネクタ22が使用されている。 回路 基板21には、通常トランジスタ、IC、LS 1等の電 子部品が実装され、また、それらを接続する導体がプリ ントされ、回路基板21の外部との接続のためには、ス トリップ状の複数の接続導体21Bが回路基板21の端 部の接続部21Aまで等間隔で平行にプリントされてい る。

体21B同士を接続するとき、図14(b)に示すよう なコネクタ22に回路基板21の接続部21Aを挿入す る。コネクタ22はハウジング23内にコンタクト24 を圧入構造で有し、コンタクト24は回路基板21の接 続部21Aを挟む挟持部24Aを二対有する。各挟持部 24Aは、各接続部21Aを挟んだ際、各接続導体21 Bと十分に接触するために、コンタクト24の金属弾性 によって相当程度の挟み圧をかけるように設定されてい る。

【0005】コンタクト24の1個は、2枚の回路基板 21の接続導体21Bの1個ずつを接続する。したがっ て、回路基板21の接続導体21Bの数に応じて複数の コンタクト24が、接続導体21Bの間隔に一致して紙 面の奥行方向に並んで設置されている。このようにし て、2枚の回路基板21の各接続部21Aにおいて、同 じ位置にある各接続導体21B同士が電気的に接続され る。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】前記従来の平行基板接 続用コネクタは、ハウジングに複数の金属コンタクトが 圧入されて構成されるが、コネクタが小型になるか又は コンタクトが狭ピッチになると、圧入工程が難しく、ま た、圧入後のコンタクトの保持力を確保し難い。

【0007】また、コンタクトの微細化が進むと、コン タクトの構造的強度が低下せざるを得ず、不慮の外力に 対する強度が不足する。

【0008】更に、コネクタの高周波特性を向上する 際、コンタクトには電気的特性と同時にばね特性という 機械的特性が要求されるため、電気的特性を良好にする

【0009】そこで、本発明は、前記従来のコネクタの 欠点を改良し、コンタクトのハウジングへの圧入構造を 除去し、ハウジングにおけるコンタクトの保持力を確保 し、コンタクトの構造的強度を向上し、しかも、電気的 特性が良好なコネクタを提供しようとするものである。 [0010]

【課題を解決するための手段】本発明は、前記課題を解 決するため、次の手段を採用する。

【0011】1. 小型基板等の接続対象物が傾斜して挿 40 入された後に回転されて接続するコネクタにおいて、前 記コネクタは、金属製のハウジングと薄板状ケーブル等 のコンタクトとから構成され、前記ハウジングには、前 記接続対象物を保持するためのラッチが一体に形成さ れ、前記コンタクトは、絶縁フィルムと、前記絶縁フィ ルム上に設けられ、かつ、前記接続対象物と接続する接 点部と、前記絶縁フイルム上に設けられ、かつ、基板に 接続する端子部と、前記接点部と前記端子部との間を接 続する接続部とから構成され、前記ハウジングは、前記 コンタクトの接点部を前記接続対象物に対して押圧する 【0004】このような回路基板21の2枚の各接続導 50 弾性部を有し、少なくとも前記コンタクトの接点部が前 (3)

特開2002-175855

3

記弾性部に固着されているコネクタ。

【0012】2. 前記弾性部と前記ハウジングとが一体に形成されている前記1記載のコネクタ。

【0013】3. 前記コネクタを前記基板に保持するためのホールドダウンと前記ハウジングとが一体に形成されている前記1記載のコネクタ。

【0014】4. 前記接続対象物が前記コネクタに揮入される際、前記接続対象物の両側を挟持する一対のばね片と前記ハウジングとが一体に形成されている前記1記載のコネクタ。

【0015】5. 前記接続対象物が前記コネクタに挿入される際、前記接続対象物の表裏逆の挿入の防止及び挿入の位置決めを行う極性キーと前記ハウジングとが一体に形成されている前記1記載のコネクタ。

[0016]

【発明の実施の形態】本発明の9つの実施の形態例のコネクタについて説明する。

【0017】まず、第1実施の形態例について図1と図2を参照して説明する。コネクタ1は、金属製のハウジング2と薄板状ケーブル3とから構成される。

【0018】ハウジング2は、枠状の本体2Aと、本体2Aの両側に直角に延出するように形成された一対のアーム部2Bと、各アーム部2Bの根元に折曲形成されたばね片2Cと、各アーム部2Bの先端付近の上側端面に折曲形成されたラッチ2Dと、本体2Aの下部両側に突出形成された一対のホールドダウン2Eとを有する。また、ハウジング2は、薄板状ケーブル3の複数の接点部3Bを小型基板4に対して押圧する弾性部(図示せず、なお、図3における符号2F参照)を有する。ハウジング2は、全体として一体形成されている。

【0019】薄板状ケーブル3は、絶縁性フィルム3Aと、整列した複数の接点部3Bと、裏面に設けられて基板と接続する複数の基板接続用半田付パッド(図示せず)と、各接点部3Bと各基板接続用半田付パッドとの間を接続する複数の接続部3Cとから構成される。薄板状ケーブル3は、少なくとも各接点部3Bがハウジング2の各弾性部に固着されている。

【0020】小型基板4をコネクタ1に嵌合するときは、次のようにして行う。すなわち、図2(a)に示されるように、小型基板4の先端部をハウジング2の本体 402A内に傾斜した姿勢で挿入し、続いて、図2(b)に示されるように、小型基板4をハウジング2に対して平行になるように押し下げる。すると、小型基板4の両側は、一対のばね片2Cにより位置決めされ、また、一対のラッチ2Dに係合し、小型基板4は、コネクタ1と嵌合する。このとき、小型基板4の先端部の裏面に設けられた複数の接点部(図示せず)は、各接点部3B、各接続部3C及び各基板接続用半田付パッドを経て基板と電気的に接続する。

【0021】次に、第2実施の形態例について図3と図 50 参照して説明する。本実施の形態例は、第2実施の形態

4

4を参照して説明する。ただし、第1実施の形態例と同様な点の説明を省略し、相違する点のみを説明する。以下、第3~第9実施の形態例についても、既述の実施例と同様な点の説明を省略し、相違する点のみを説明する。

【0022】ハウジング2の本体2Aの内部の上下両側に、それぞれ複数の押圧力発生用弾性部2Fを整列させて折曲形成する。

【0023】薄板状ケーブル3の絶縁性フィルム3Aの表面の2箇所には、それぞれ整列した複数の接点部3Bが設けられ、また、裏面には基板と接続する整列した複数の基板接続用半田付パッド3Dが設けられている。

【0024】図4(a)に示されるように、ハウジング2の本体2Aの内部に湾曲して装着された薄板状ケーブル3の間に、図4(b)に示されるように、小型基板4の先端部を傾斜した姿勢で挿入する。続いて、小型基板4を矢印方向に回転させて、図4(c)に示される水平位置まで至らせる。すると、小型基板4の表面の複数の接点部(図示せず)は、それぞれ薄板状ケーブル3の上側の各接点部3Bに本体2Aの上側の各押圧力発生用弾性部2Fにより押圧されて接触し、また、小型基板4の裏面の複数の接点部(図示せず)は、それぞれ薄板状ケーブル3の下側の各接点部3Bに本体2Aの下側の各押圧力発生用弾性部2Fにより押圧されて接触する。

【0025】続いて、第3実施の形態例について図5と図6を参照して説明する。本実施の形態例における薄板状ケーブル3には、第2実施の形態例における複数の基板接続用半田付パッド3Dに代えて薄板状ケーブル3の表面にボールグリッドアレイ3Eを設ける。

【0026】更に、第4実施の形態例について図7と図8を参照して説明する。第2実施の形態例では、ハウジング2の本体2Aの内部の上下両側に、それぞれ複数の押圧力発生用弾性部2Fを整列させて折曲げ形成する。これに対して、第4実施の形態例では、本体2Aの上下両側の端部に、それぞれ複数の押圧力発生用弾性部5Aを有するハウジングと別体の弾性部材5の略U字状部5Bをはめ込む。

【0027】更に、第5実施の形態例について図9を参照して説明する。本実施の形態例は、第4実施の形態例における複数の基板接続用半田付パッド3Dに代えてボールグリッドアレイ3Eを採用する。

【0028】更に、第6実施の形態例について図10を参照して説明する。第3実施の形態例では、ハウジング2の本体2Aの内部の上下両側に、それぞれ複数の押圧力発生用弾性部2Fを整列させて折曲形成する。これに対して、第6実施の形態例では、上下両側の各押圧力発生用弾性部2Fを除去し、代わりに本体2Aの内部の上下両側にそれぞれゴムブロック6を取り付けられる。

【0029】更に、第7実施の形態例について図11を 参照して説明する。本実施の形態例は 第2実施の形態

特開2002-175855

5

例におけるハウジング2の本体2Aの内部の上側に、極性キー7を取り付けられる。極性キー7をハウジング2と一体に形成することもできる。小型基板4の表面側には、極性キー7に相応するキー溝(図示せず)が設けられる。したがって、小型基板4は、表裏が正しい状態ではコネクタ1に嵌合されるが、表裏が逆の状態(裏返し)でコネクタ1に嵌合されることを防止される。また、極性キー7とキー溝とは、ハウジング2における小型基板4の位置決めの機能をも営む。

【0030】更に、第8実施の形態例について図12を 10 参照して説明する。本実施の形態例は、第1実施の形態例における絶縁性フィルム3Aの表面に、各接続部3C上の位置を避けて複数のチップ部品8を搭載する。このように構成すると、コネクタ1内のスペースを有効に利用することができる。

【0031】更に、第9実施の形態例について図13を参照して説明する。第1実施の形態例では、薄板状ケーブル3の幅は、ハウジング2の一対のアーム部2Bの間に収まる。これに対して、第9実施の形態例では、延展拡張した薄板状ケーブル9を使用する。

[0032]

【発明の効果】以上の説明から明らかなように、本発明 によれば、次の効果を奏することができる。

【0033】1. 薄板状ケーブル等のコンタクトをハウジングに圧入する必要がなく、コンタクトを確実に保持できる。

【0034】2. コンタクトは敬細化を要求されないから、コンタクトの構造的強度は低下することなく、また、不慮の外力によりコンタクトは変形しない。

【0035】3. コンタクトの接点部を小型基板等の接 30 1 続対象物に対して押圧するハウジングの弾性部と、コン 2 タクトとが別個の部材として構成されるため、電気的特 2 性の向上が容易になる。 2

【0036】4. コンタクトにチップ部を搭載できるから、コネクタに回路機能を付加することが容易であるので、嵌合される接続対象物の回路機能の一部をコネクタが負担できる。したがって、接続対象物の価格を低減できる。

【0037】5. 薄板状ケーブルは自由に拡張可能であるため、コネクタの信号ラインと接続される回路をコネ 40 クタ外に容易に構成できる。

【0038】6. 薄板状ケーブルは柔軟性に富むため、その表面上にチップ部品を実装した後に畳み込むと、高密度の三次元実装が可能になる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1実施の形態例のコネクタの斜視図である。

【図2】同コネクタと小型基板との斜視図であり、

- (a) は小型基板を同コネクタに挿入する途中の状態、
- (b) は小型基板を同コネクタに嵌合した状態を、それ 50 8

ぞれ示す。

【図3】本発明の第2実施の形態例のコネクタの斜視図である。

【図4】同コネクタに小型基板を挿入する前の状態から 嵌合が完了するまでの過程の断面図を、順次(a)~ (c)に示す。

【図5】本発明の第3実施の形態例のコネクタの斜視図 である。

【図6】同コネクタに小型基板を挿入する前の状態から 嵌合が完了するまでの過程の断面図を、順次(a)~ (c)に示す。

【図7】本発明の第4実施の形態例のコネクタの斜視図である。

【図8】同コネクタの断面図である。

【図9】本発明の第5実施の形態例のコネクタの断面図である。

【図10】本発明の第6実施の形態例のコネクタに小型 基板を挿入する前の状態から嵌合が完了するまでの過程 の断面図を、順次(a)~(c)に示す。

20 【図 1 1】本発明の第7実施の形態例のコネクタの斜視 図である。

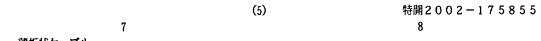
【図12】本発明の第8実施の形態例のコネクタの斜視 図である。

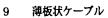
【図13】本発明の第9実施の形態例のコネクタの斜視図である。

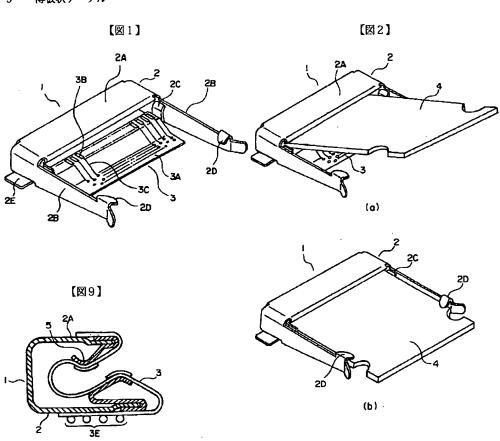
【図14】従来の平行基板接続用コネクタと回路基板であり、(a)は回路基板の正面図、(b)はコネクタに回路基板を嵌合した状態の断面図を、それぞれ示す。

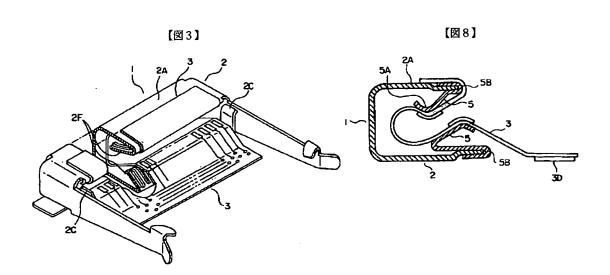
【符号の説明】

- 1 コネクタ
 - 2 ハウジング
- 2 A 本体
- 2B アーム部
- 2 C ばね片
- 2D ラッチ
- 2E ホールドダウン
- 2 F 押圧力発生用弾性部
- 3 薄板状ケーブル
- 3A 絶縁性フィルム
- 3 B 接点部
- 3 C 接続部
- 3D 基板接続用半田付パッド
- 3E ボールグリッドアレイ
- 4 小型基板
- 5 弹性部材
- 5 A 押圧力発生用弾性部
- 5 B 略U字状部
- 6 ゴムブロック
- 7 極性キー
- 8 チップ部品





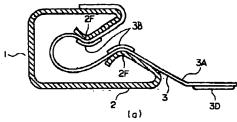


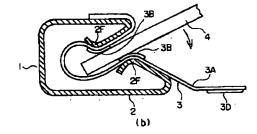


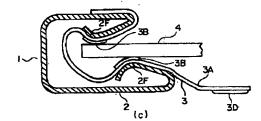
(6)

特開2002-175855

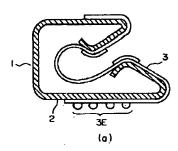


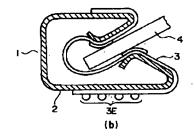


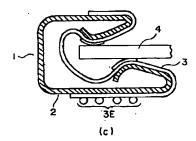




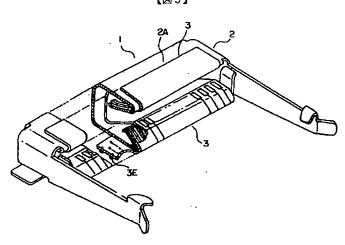
[図6]







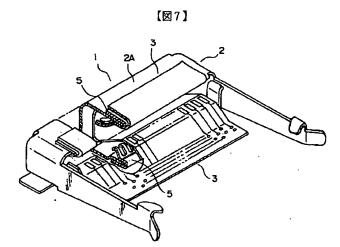
【図5】

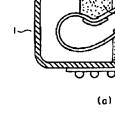


(7)

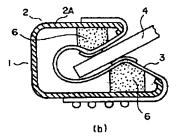
特開2002-175855

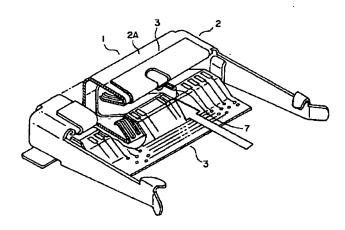
[図10]

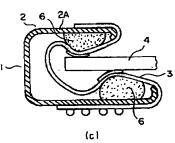




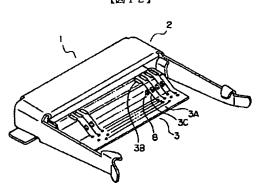








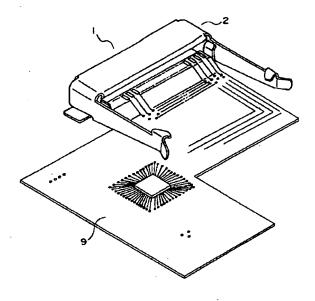
【図12】

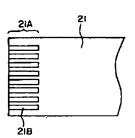


(8)

特開2002-175855

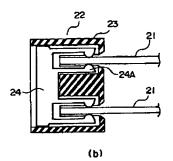






(o)

【図14】



フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7

識別記号

テーマコード(参考)

HO1R 12/16

// HO1R 107:00

FΙ HO1R 23/02

23/68

M

303C

(72)発明者 鈴木 敬一郎

東京都渋谷区道玄坂1丁目21番2号 日本

航空電子工業株式会社内

Fターム(参考) 5E021 FA05 FA11 FB01 FB02 FC01

FC31 FC36 FC38 HA07 HC12

JA04 KA05 MA01 MA30 MA31

5E023 AA04 AA10 AA16 AA29 BB01

BB22 BB25 CCO2 CC23 CC24

CC26 DD25 DD28 EE09 EE22

FF01 GG08 GG09 GG15 GG17

HH01 HH17 HH22